

2025年3月期第2四半期 決算説明会

2024年11月15日

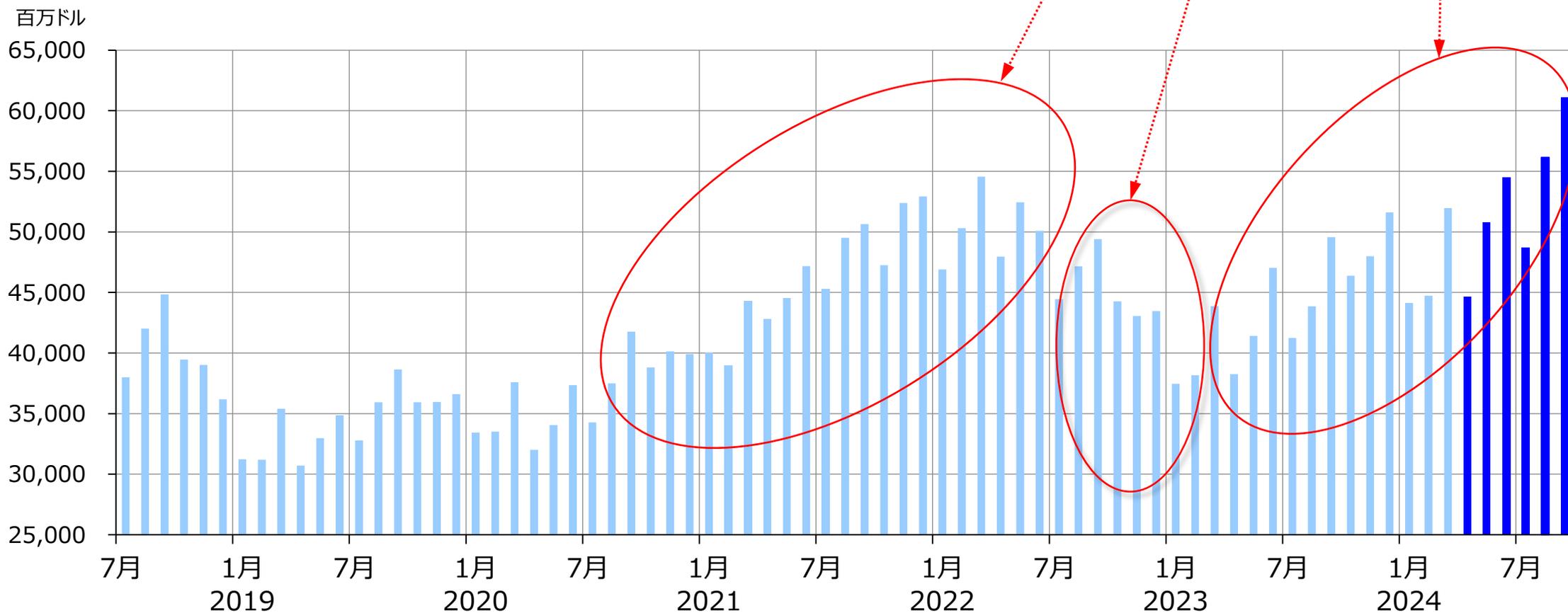
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2024年9月まで）

出所：WSTS（2024/11）

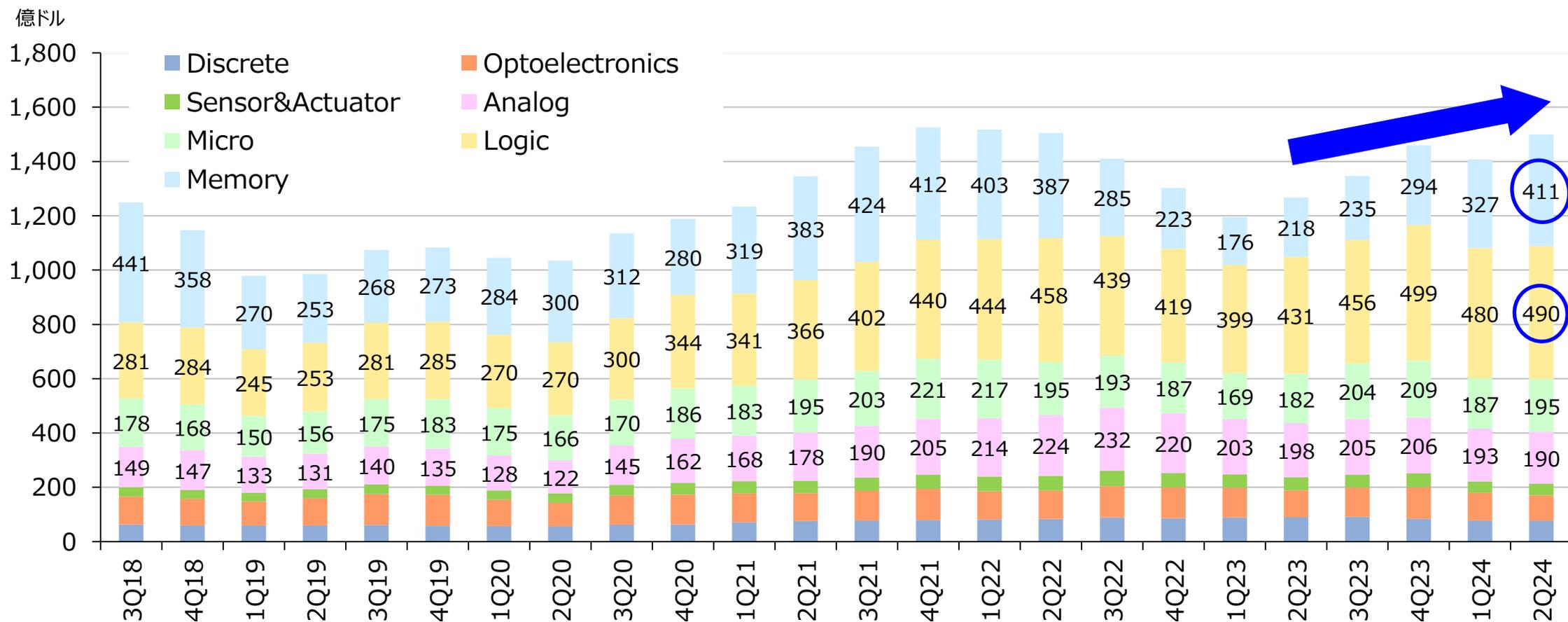
- 2020年、新型コロナの影響で1月より下降 同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続
- 2022年7月以降、生産及び在庫の調整が見られ減速、23年1月には2年半前（20年8月）の水準を割り込むまで下落、その後、AI関連需要を追い風に金額ベースでは回復基調を示しているが、数量ベースの本格的な回復に向かうのか、今後の動向に注視が必要



世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

出所：WSTS

- 2023年2Q（4-6月期）以降、高価格のAI向け半導体の影響で半導体市場は拡大が続いている
- 2024年2Q（4-6月期） ロジック(QoQ +2%, YoY +14%) メモリ(QoQ +26%, YoY +89%)



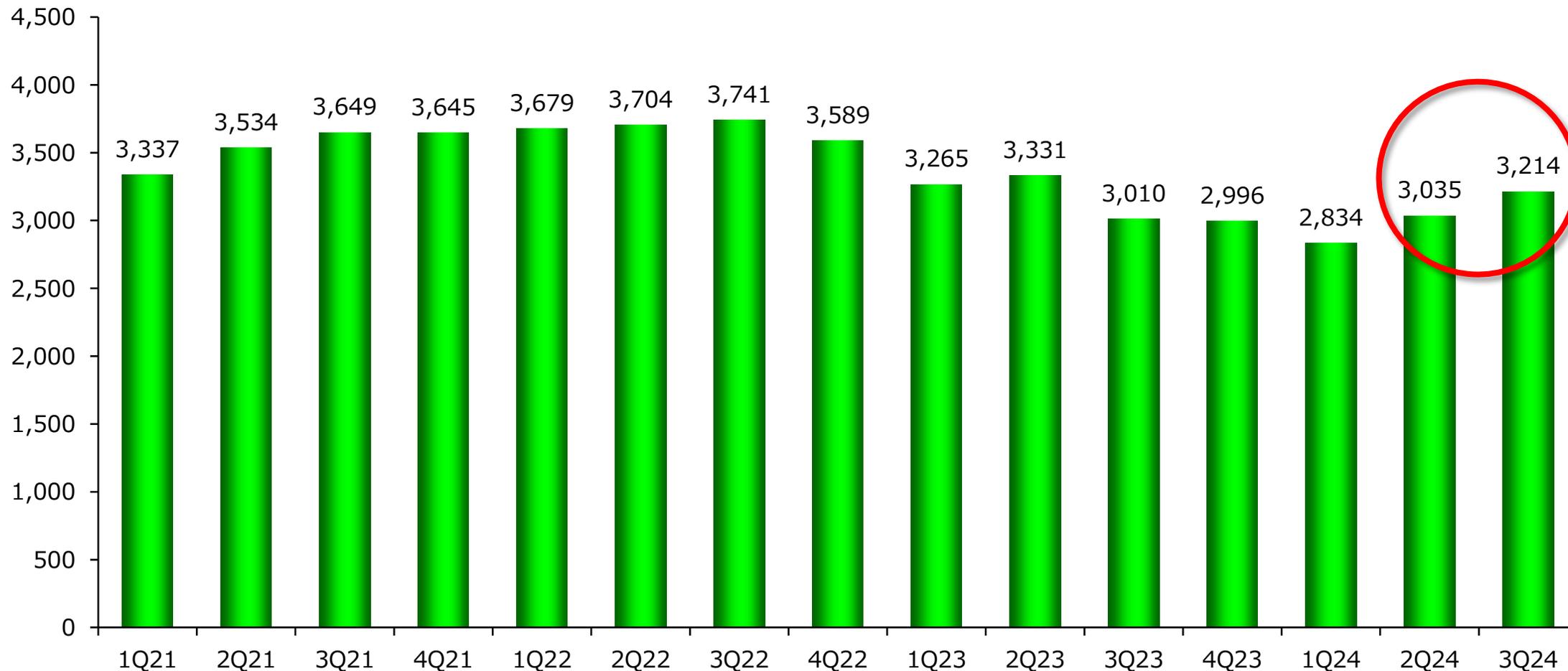
《暦年ベース》

シリコンウェハー出荷面積 実績 (四半期)

出所：SEMI (2024/10/24)

- 2024年2Q QoQ +7% 3Q QoQ +6%
- データセンター及びAI向け製品に関連する旺盛な需要により、2四半期連続で回復傾向

百万平方インチ

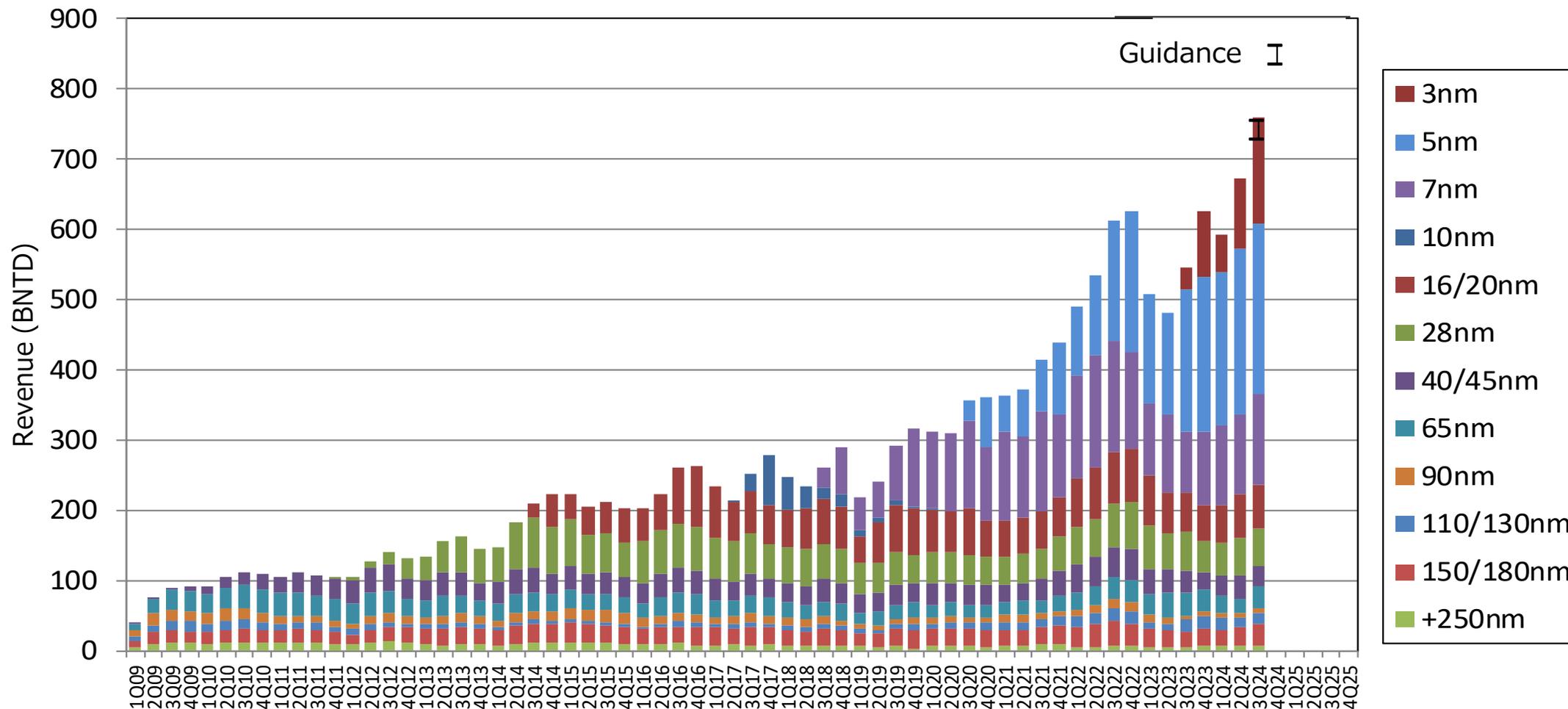


《暦年ベース》

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2024年7-9月期）

出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

- 24年3Q（7-9月期） QoQ +13%, YoY +36% QoQでは、3,5,7nmの売上高が増加
- 24年4Q（10-12月期）ガイダンス QoQ +11% ~ +14%
- 24年の設備投資計画 280-320億米ドル（23年通期 304億米ドル）

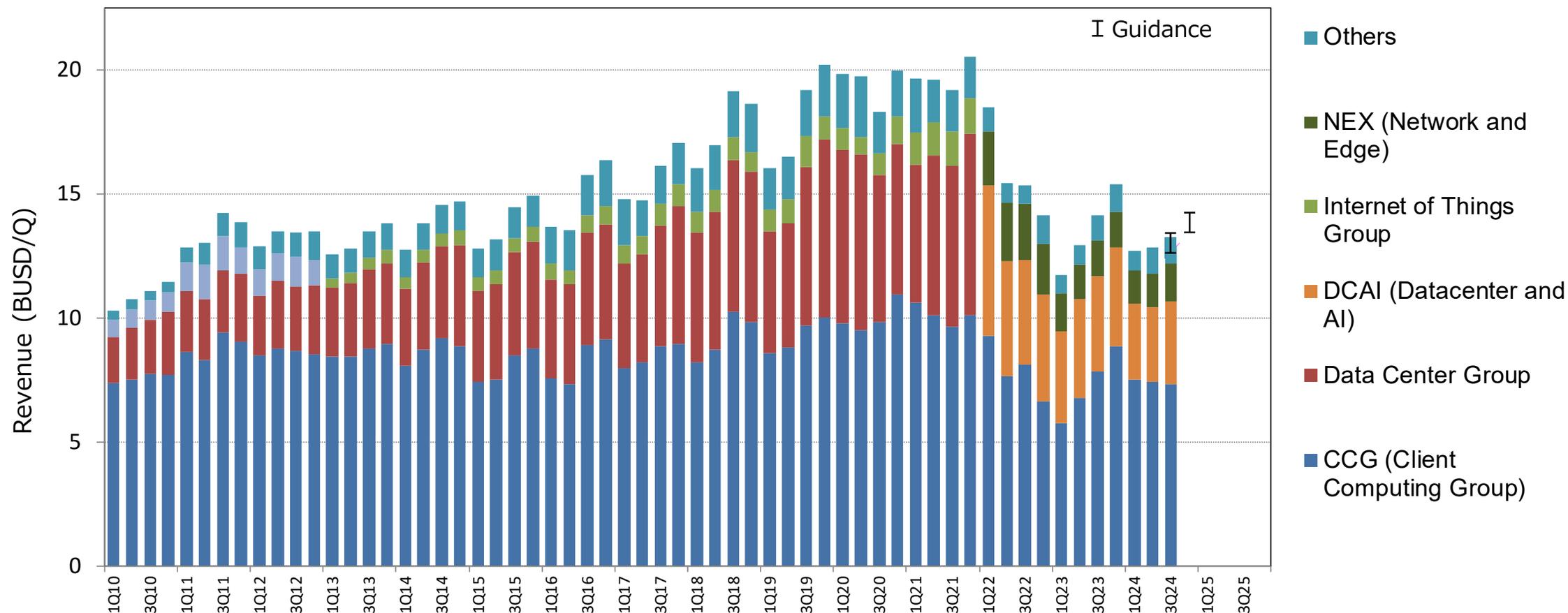


《暦年ベース》

Intel 売上高 (2024年7-9月期)

出所：Intel公開情報よりフジミ作成

- 24年3Q (7-9月期) QoQ +4%, YoY -6% 前年同期比では、主にPC関連が減少
- 24年4Q (10-12月期) ガイダンス QoQ 0% ~ +8%



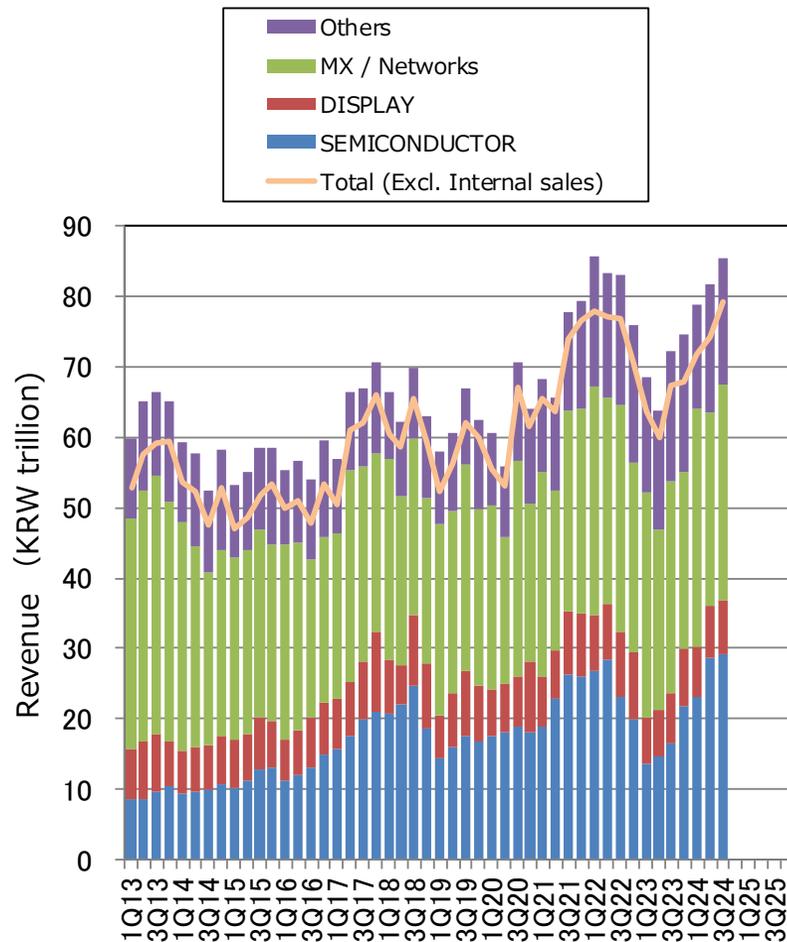
《暦年ベース》

サムスン電子 売上高 (2024年7-9月期)

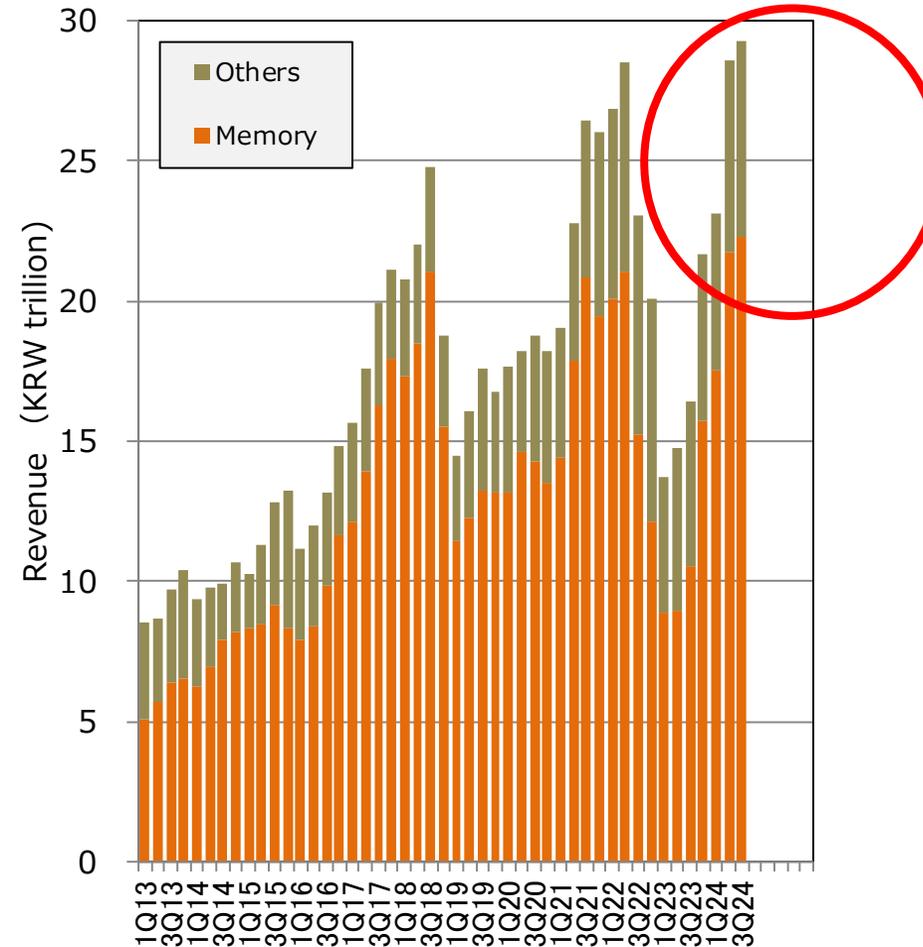
出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

- 半導体事業の24年3Q (7-9月期) 売上高 QoQ +3%, YoY +78%

<Samsung Total>



<Semiconductor Division>

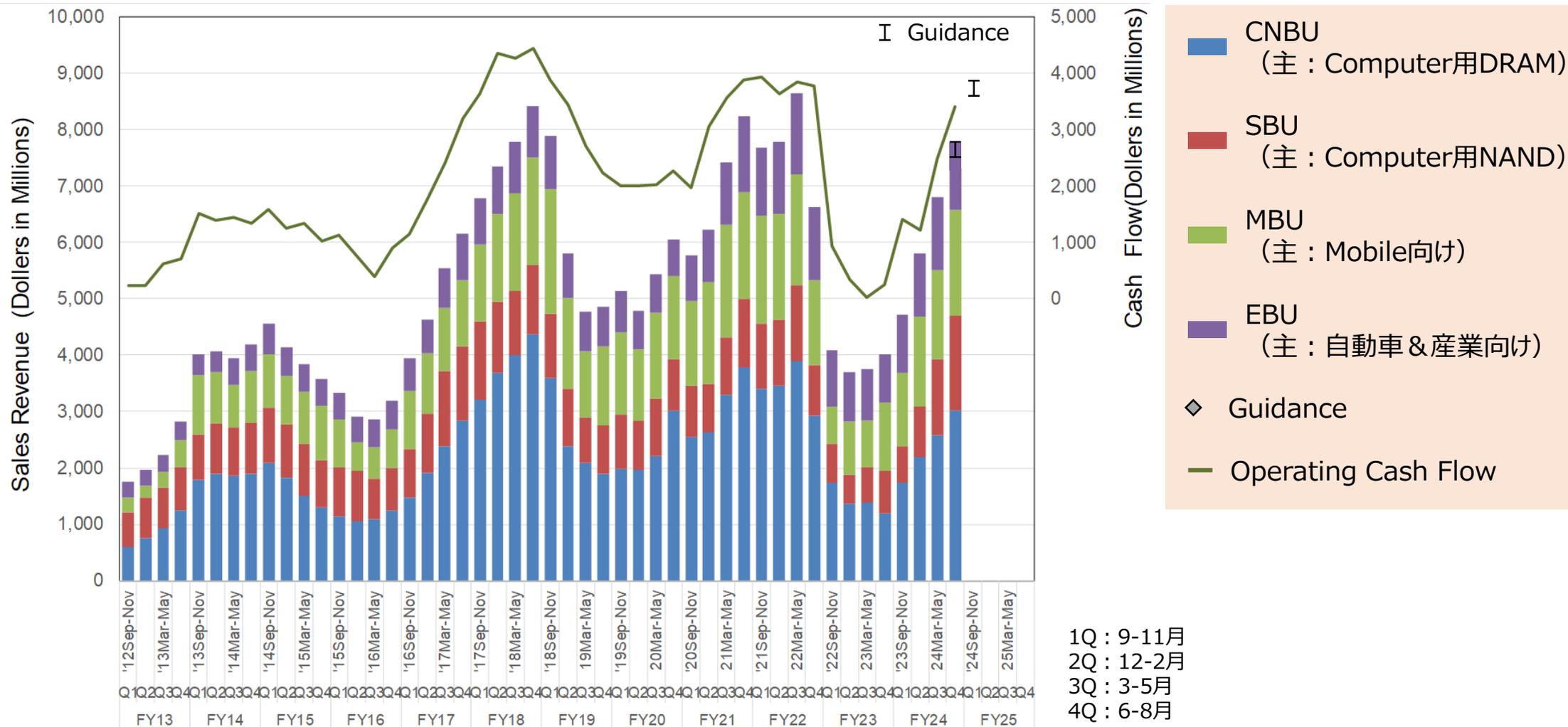


《暦年ベース》

マイクロン・テクノロジー 売上高 (2024年6月-2024年8月期)

出所：マイクロン・テクノロジー公開情報よりフジミ作成

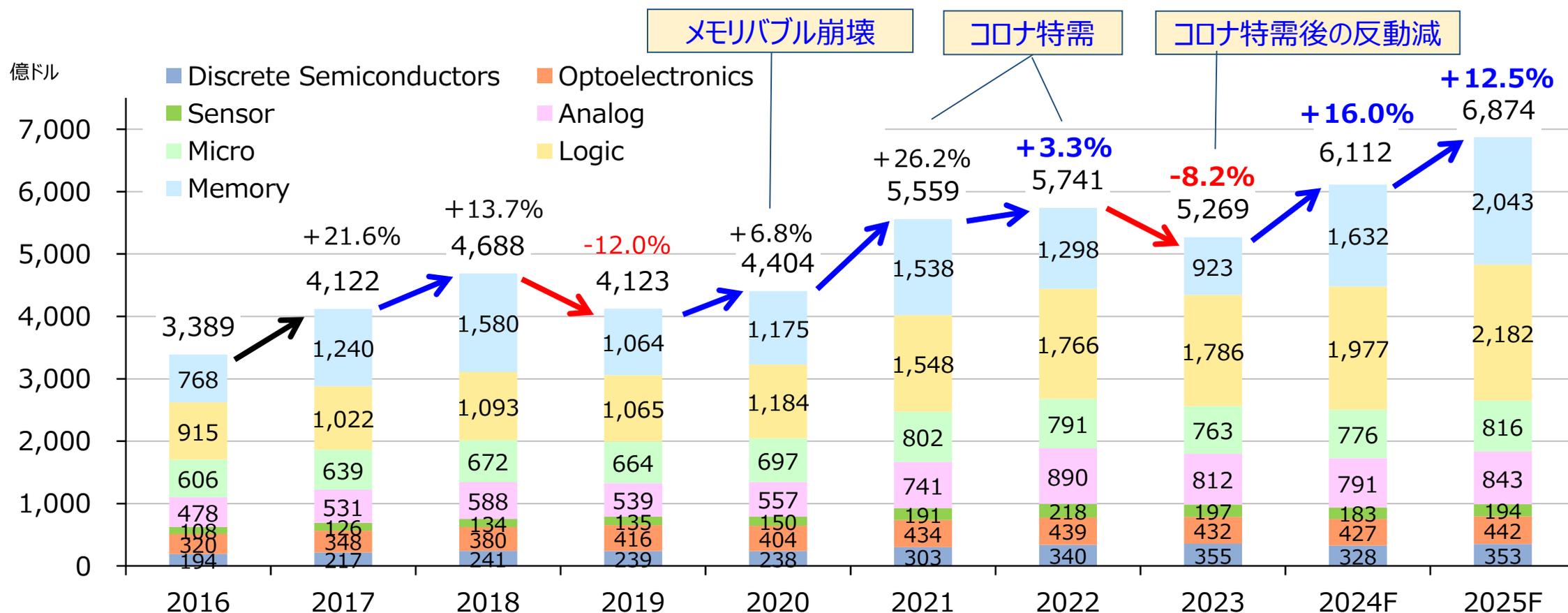
- 24年6-8月期 QoQ +14% YoY +93%
堅調なA I 需要がデータセンター向けのD R A Mと高帯域幅メモリ製品の売上急増を牽引
- 24年9-11月期 ガイダンス QoQ +9~14%



世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

出所：WSTS（2024/6/4）

- ・ 2024年の市場予想は、AI関連を除く半導体需要は低調に推移するも、旺盛なAI関連投資を背景に、+16.0%を見込む
- ・ 2025年の市場予想は、AI関連需要に加え、環境対応や自動化等の成長領域を念頭に、+12.5%を見込む

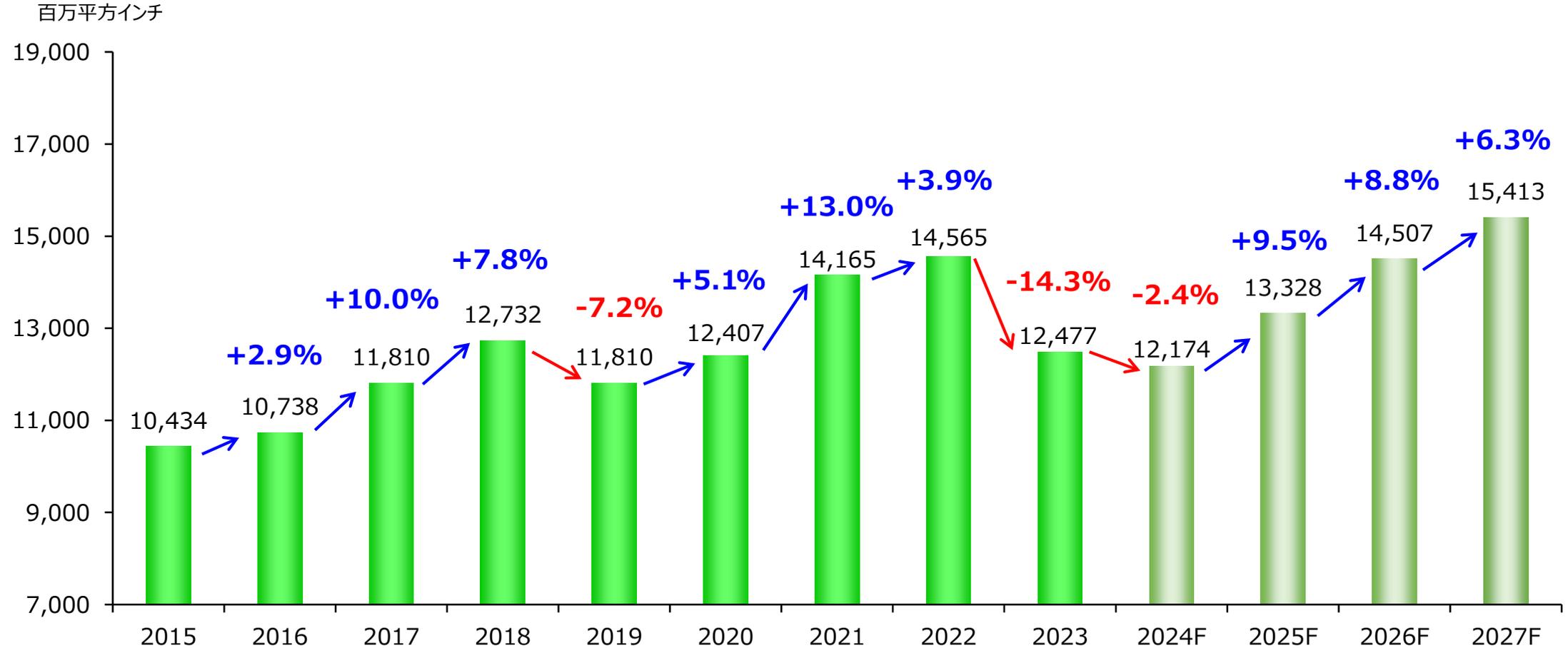


《暦年ベース》

シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径）

出所：SEMI (2024/10/24)

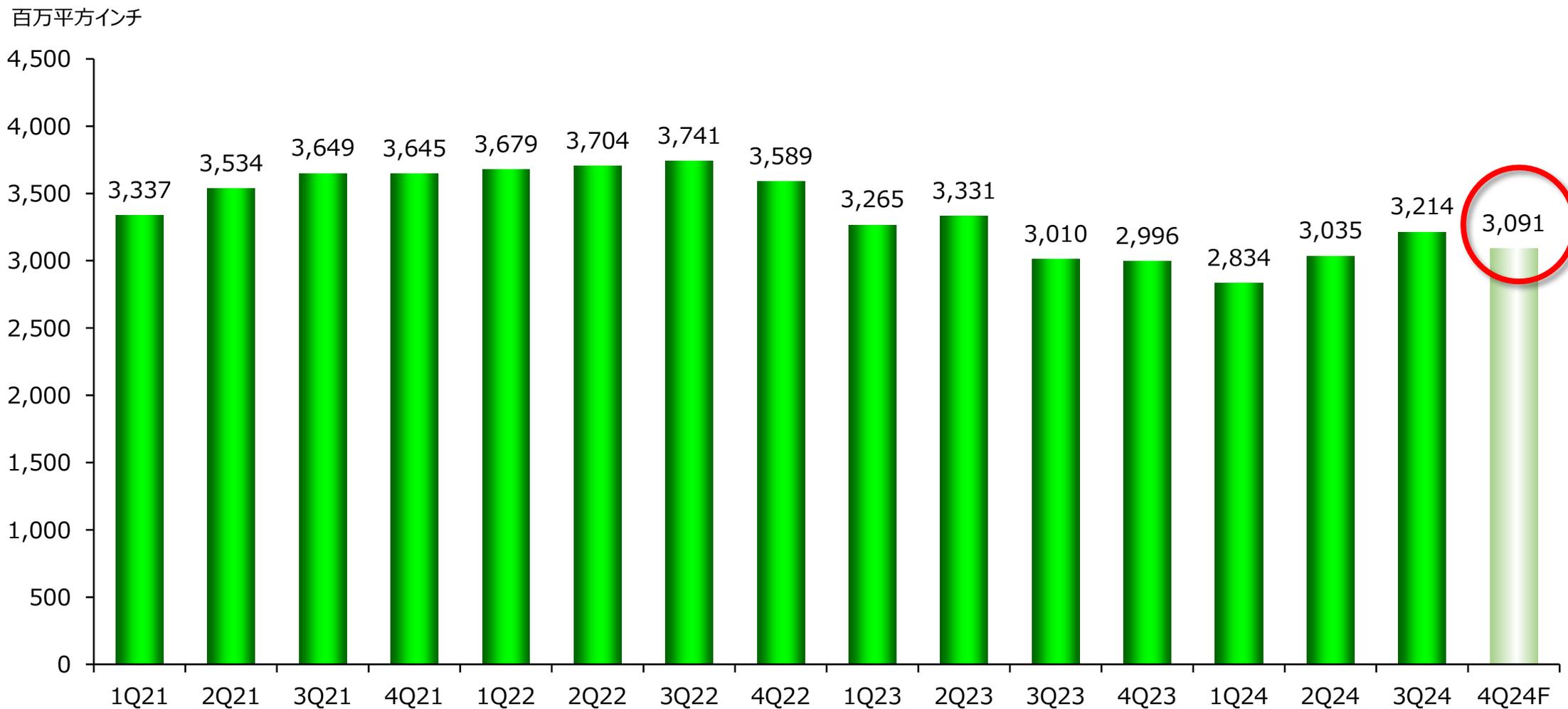
- 2024年、シリコンウェハー需要予測はマイナスを継続 YoY -2.4%



シリコンウェハー出荷面積 実績 (四半期)

出所：SEMI (2024/10/24)

- 2024年4Q QoQ -4% (SEMI公開情報より算出)



4Q24F：SEMI公開情報よりフジミ算出

《暦年ベース》

決算概要

決算概要 (上期実績)

単位：百万円

	24年3月期		25年3月期						
	上期実績	下期実績	上期 期初予想 ('24/5)	上期 修正予想 ('24/9)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('24/5)	修正予想比 ('24/9)
売上高	25,352	26,070	27,200	30,300	30,746	+21.3%	+17.9%	+13.0%	+1.5%
営業利益 率	3,949 15.6%	4,301 16.5%	4,100 15.1%	5,250 17.3%	5,702 18.5%	+44.4% -	+32.6% -	+39.1% -	+8.6% -
経常利益 率	4,430 17.5%	4,527 17.4%	4,200 15.4%	5,600 18.5%	5,620 18.3%	+26.9% -	+24.1% -	+33.8% -	+0.4% -
四半期純利益 率	3,377 13.3%	3,121 12.0%	3,200 11.8%	4,250 14.0%	4,370 14.2%	+29.4% -	+40.0% -	+36.6% -	+2.8% -

・増収増益

- 半導体向け製品を中心とした販売増加に加え円安効果

・経常利益

- 上期末に向けて一時的に円高が進行したことを受け、営業外損益で為替差損（△322）発生

・為替実績：152円／ドル（前年同期：141円／ドル）

・EBITDAマージン：21.6%（前年同期：19.4%）

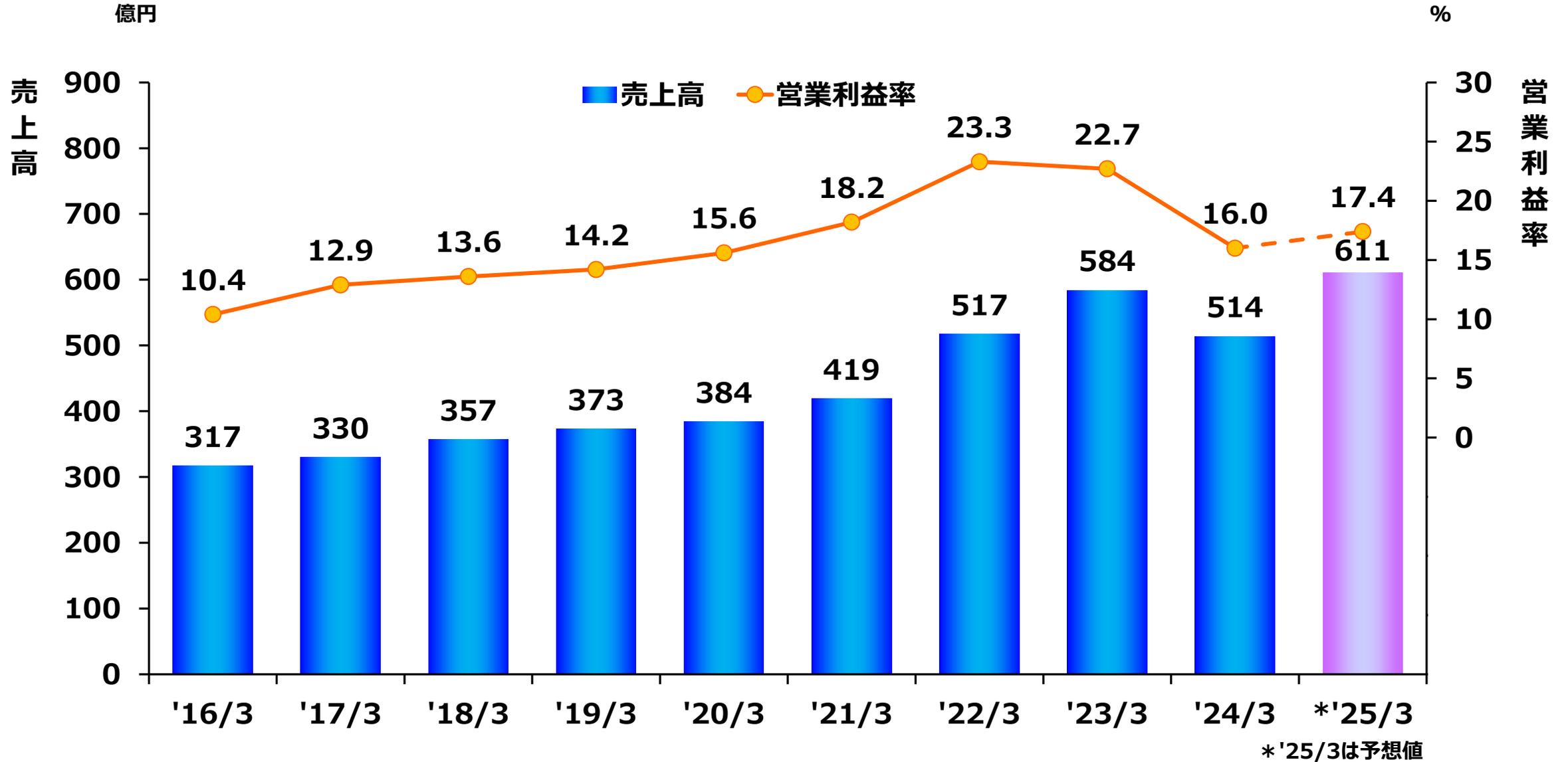
業績予想 (通期予想)

単位：百万円

	24年3月期	25年3月期			
	通期実績	期初予想 ('24/5)	修正予想 ('24/9)	前期比	期初予想比 ('24/5)
売上高	51,423	54,700	61,100	+18.8%	+11.7%
営業利益 率	8,251 16.0%	8,500 15.5%	10,650 17.4%	+29.1% -	+25.3% -
経常利益 率	8,958 17.4%	8,700 15.9%	11,150 18.2%	+24.5% -	+28.2% -
当期純利益 率	6,499 12.6%	6,500 11.9%	8,350 13.7%	+28.5% -	+28.5% -

- ・増収増益予想
- ・世界半導体市場の回復については各々の用途によりバラつき感が見られ、本格的な回復には時間を要すると想定し、9月発表の修正予想を据え置き
- ・想定為替レート：下期145円／ドル（前年下期実績：148円／ドル）
通期148.5円／ドル（前年実績：144円／ドル）
- ・EBITDAマージン：20.7%（前期：20.0%）

業績推移 (今期予想含む)



用途別売上高

用途別売上高（上期実績）

単位：百万円

		24年3月期		25年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('24/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('24/5)
シリコンウェハ	ラッピング	2,818	2,655	2,800	3,791	+34.5%	+42.8%	+35.4%
	ポリシング	5,487	4,422	5,450	6,123	+11.6%	+38.5%	+12.4%
	切断	98	88	50	81	△17.6%	△8.0%	+62.5%
	計	8,404	7,165	8,300	9,996	+18.9%	+39.5%	+20.4%
CMP		12,962	14,439	14,450	15,033	+16.0%	+4.1%	+4.0%
ディスク	アルミディスク	467	912	750	1,286	+175.5%	+41.1%	+71.6%
	ガラスディスク	3	1	0	3	+5.2%	+248.1%	-
	計	470	913	750	1,290	+174.2%	+41.3%	+72.1%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,229	2,249	2,350	2,639	+18.4%	+17.3%	+12.3%
	一般工業用(非研磨材)	1,251	1,228	1,300	1,708	+36.6%	+39.0%	+31.4%
	計	3,480	3,478	3,650	4,348	+24.9%	+25.0%	+19.1%
製品売上高		25,318	25,996	27,150	30,668	+21.1%	+18.0%	+13.0%
商品売上高		34	73	50	78	+124.8%	+6.3%	+56.0%
売上高 合計		25,352	26,070	27,200	30,746	+21.3%	+17.9%	+13.0%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円

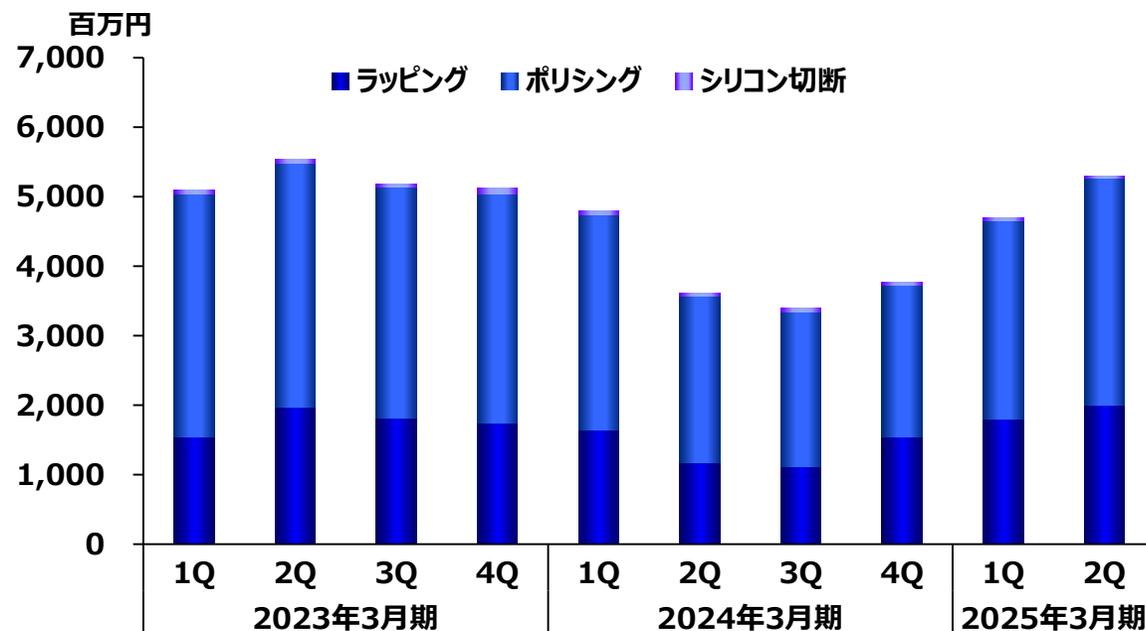
		23年3月期	24年3月期	25年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('24/5)	通期 修正予想	前期比	期初予想比 ('24/5)
シリコンウェハ	ラッピング	7,054	5,474	5,650	7,500	+37.0%	+32.7%
	ポリシング	13,610	9,909	10,950	12,150	+22.6%	+11.0%
	切断	239	186	100	150	△19.7%	+50.0%
	計	20,904	15,570	16,700	19,800	+27.2%	+18.6%
CMP		28,668	27,401	28,900	29,900	+9.1%	+3.5%
ディスク	アルミディスク	1,468	1,379	1,500	2,590	+87.8%	+72.7%
	ガラスディスク	37	4	0	10	+111.8%	-
	計	1,506	1,383	1,500	2,600	+87.9%	+73.3%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,610	4,479	4,900	5,300	+18.3%	+8.2%
	一般工業用(非研磨材)	2,601	2,480	2,600	3,400	+37.1%	+30.8%
	計	7,211	6,959	7,500	8,700	+25.0%	+16.0%
製品売上高		58,290	51,314	54,600	61,000	+18.9%	+11.7%
商品売上高		103	108	100	100	△7.5%	+0.0%
売上高 合計		58,394	51,423	54,700	61,100	+18.8%	+11.7%

シリコンウェハー売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		24年3月期		25年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('24/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('24/5)
シリコンウェハー	ラッピング	2,818	2,655	2,800	3,791	+34.5%	+42.8%	+35.4%
	ポリシング	5,487	4,422	5,450	6,123	+11.6%	+38.5%	+12.4%
	切断	98	88	50	81	△17.6%	△8.0%	+62.5%
	計	8,404	7,165	8,300	9,996	+18.9%	+39.5%	+20.4%



・ 事業環境

- シリコンウェハー出荷面積は、2022年10-12月期から減少を続けていたが、2024年4-6月期に増加に反転
- 2024年7-9月期も顧客の稼働は回復傾向

・ ラッピング、ポリシング製品の増収要因

- 上記事業環境下、上期は需要が増加傾向
- 原材料価格上昇分の製品価格への転嫁（ラッピング）

シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

シリコンウェハーの生産の本格的な回復には時間を要するものと想定し、下期は上期比で微減となるも、通期では前期比大幅増収を見込む

「下期」

単位：百万円

		24年3月期		25年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('24/5)	下期修正予想 ('24/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('24/5)
シリコンウェハー	ラッピング	2,818	2,655	3,791	2,850	3,709	+39.7%	△2.2%	+30.1%
	ポリシング	5,487	4,422	6,123	5,500	6,026	+36.3%	△1.6%	+9.6%
	切断	98	88	81	50	69	△21.9%	△15.1%	+38.0%
	計	8,404	7,165	9,996	8,400	9,804	+36.8%	△1.9%	+16.7%

「通期」

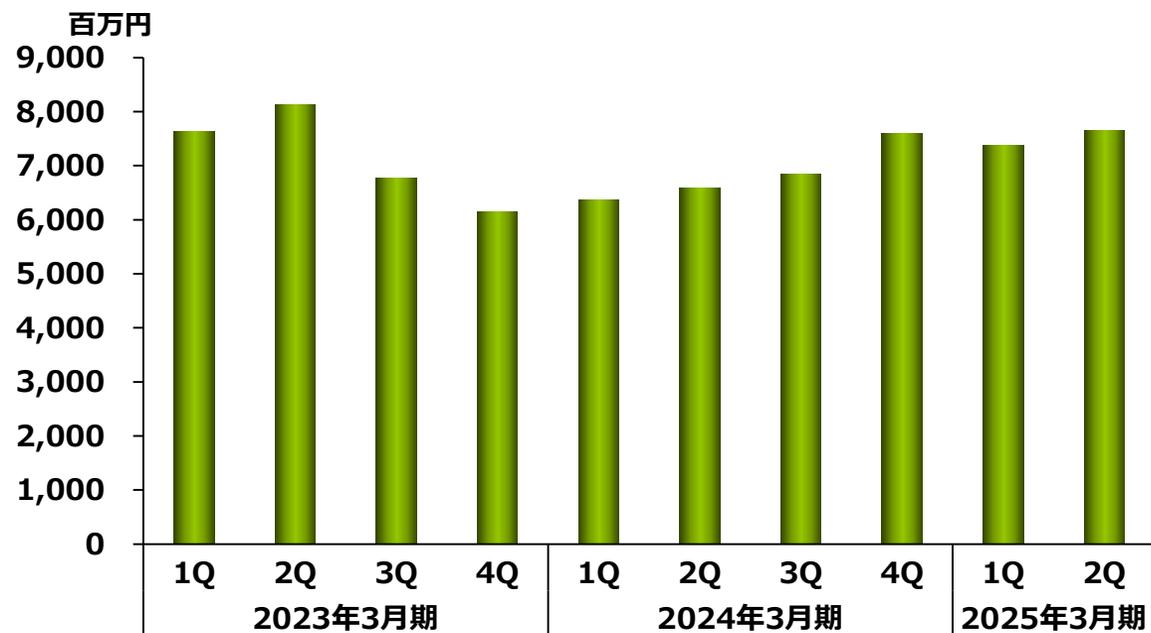
単位：百万円

		23年3月期	24年3月期	25年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('24/5)	通期修正予想 ('24/11)	前期比	期初予想比 ('24/5)
シリコンウェハー	ラッピング	7,054	5,474	5,650	7,500	+37.0%	+32.7%
	ポリシング	13,610	9,909	10,950	12,150	+22.6%	+11.0%
	切断	239	186	100	150	△19.7%	+50.0%
	計	20,904	15,570	16,700	19,800	+27.2%	+18.6%

《上期》

単位：百万円

	24年3月期		25年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('24/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('24/5)
CMP	12,962	14,439	14,450	15,033	+16.0%	+4.1%	+4.0%



- ・ 事業環境
 - AI向け先端半導体デバイスの需要は堅調
 - 一方で、PCやスマートフォン向け等の需要は力強さを欠いており、全体としては依然バラつき感が見られた
- ・ CMP向け製品の増収要因
 - AI関連の先端ロジックデバイスやメモリ向けの販売が増加

CMP売上高（下期予想・通期予想）

・半導体の生産の本格的な回復には時間を要すると想定し、下期では上期比でほぼフラットも、通期では前期比増収を見込む

「下期」

単位：百万円

	24年3月期		25年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('24/5)	下期修正予想 ('24/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('24/5)
CMP	12,962	14,439	15,033	14,450	14,867	+3.0%	△1.1%	+2.9%

「通期」

単位：百万円

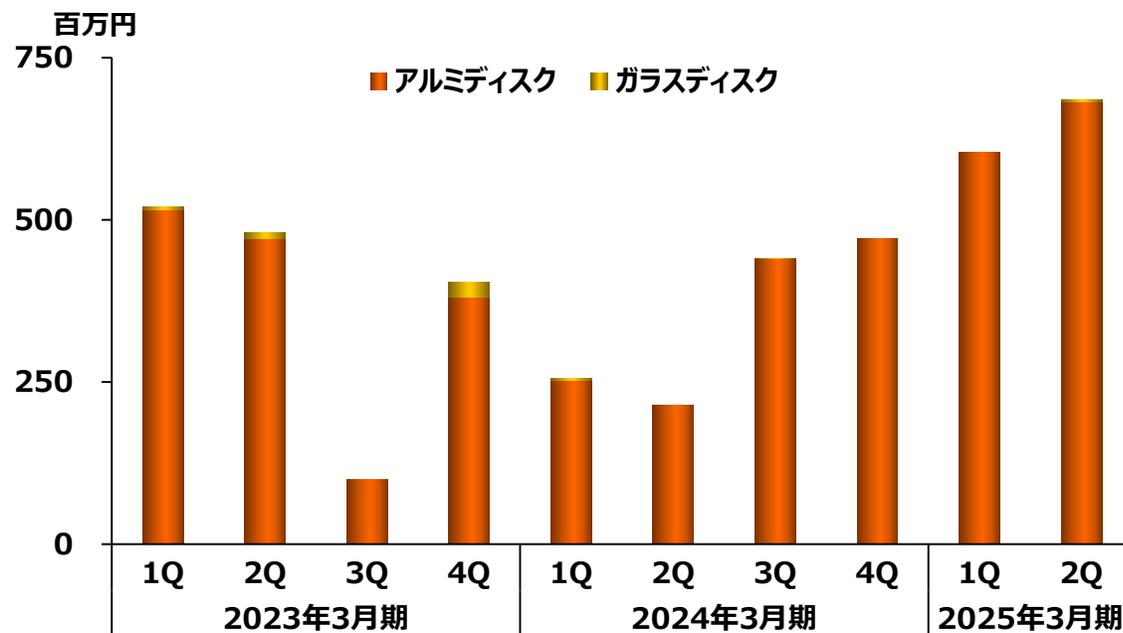
	23年3月期	24年3月期	25年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想 ('24/5)	通期修正予想 ('24/11)	前期比	期初予想比 ('24/5)
CMP	28,668	27,401	28,900	29,900	+9.1%	+3.5%

ディスク売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		24年3月期		25年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('24/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('24/5)
ディスク	アルミディスク	467	912	750	1,286	+175.5%	+41.1%	+71.6%
	ガラスディスク	3	1	0	3	+5.2%	+248.1%	-
	計	470	913	750	1,290	+174.2%	+41.3%	+72.1%



- ・ 事業環境
 - データセンター向けHDDの需要増加
- ・ アルミディスク向け製品の増収要因
 - 上記要因により需要増加

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

・データセンター向けHDDの需要が高水準で推移すると想定し、通期で前期比大幅増収を見込む

「下期」

単位：百万円

		24年3月期		25年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('24/5)	下期修正予想 ('24/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('24/5)
ディスク	アルミディスク	467	912	1,286	750	1,303	+42.9%	+1.3%	+73.7%
	ガラスディスク	3	1	3	0	7	+538.6%	+83.5%	-
	計	470	913	1,290	750	1,310	+43.5%	+1.5%	+74.7%

「通期」

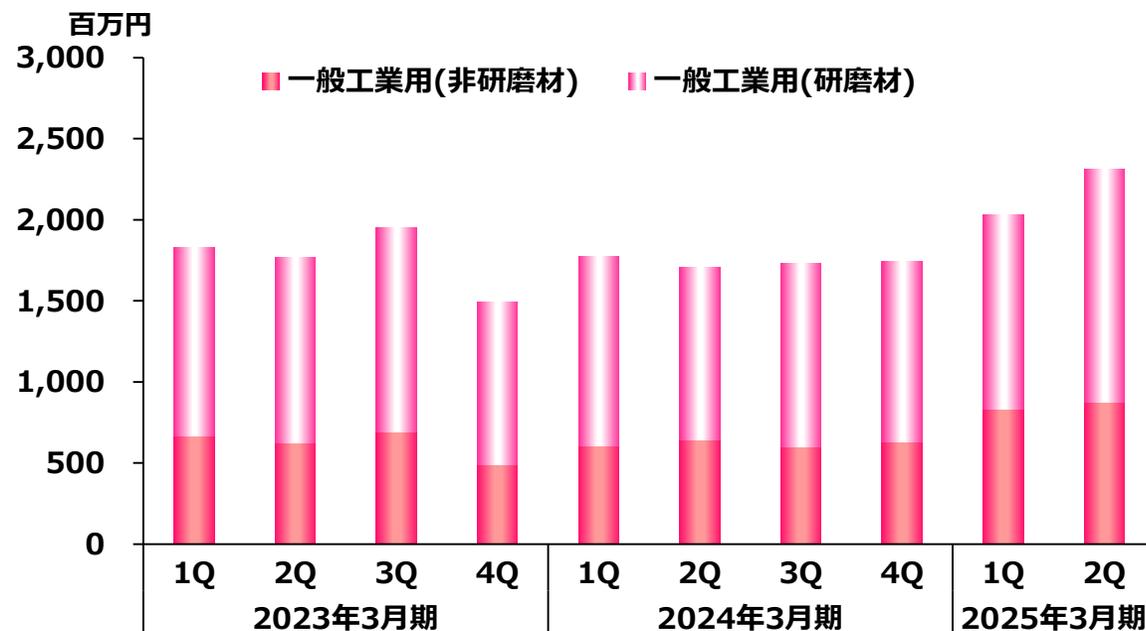
単位：百万円

		23年3月期	24年3月期	25年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('24/5)	通期修正予想 ('24/11)	前期比	期初予想比 ('24/5)
ディスク	アルミディスク	1,468	1,379	1,500	2,590	+87.8%	+72.7%
	ガラスディスク	37	4	0	10	+111.8%	-
	計	1,506	1,383	1,500	2,600	+87.9%	+73.3%

《上期》

単位：百万円

		24年3月期		25年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('24/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('24/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,229	2,249	2,350	2,639	+18.4%	+17.3%	+12.3%
	一般工業用(非研磨材)	1,251	1,228	1,300	1,708	+36.6%	+39.0%	+31.4%
	計	3,480	3,478	3,650	4,348	+24.9%	+25.0%	+19.1%



- ・ 事業環境
 - 各種用途において、需要が堅調に推移
 - 半導体製造装置の設備投資が堅調に推移
- ・ 一般工業用（研磨材）の増収要因
 - 上記要因により需要増加
- ・ 一般工業用（非研磨材）の増収要因
 - 上記要因により需要増加

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

・ 各種用途において、需要が高水準で推移すると想定し、下期は上期比でフラット、通期で増収を見込む

「下期」

単位：百万円

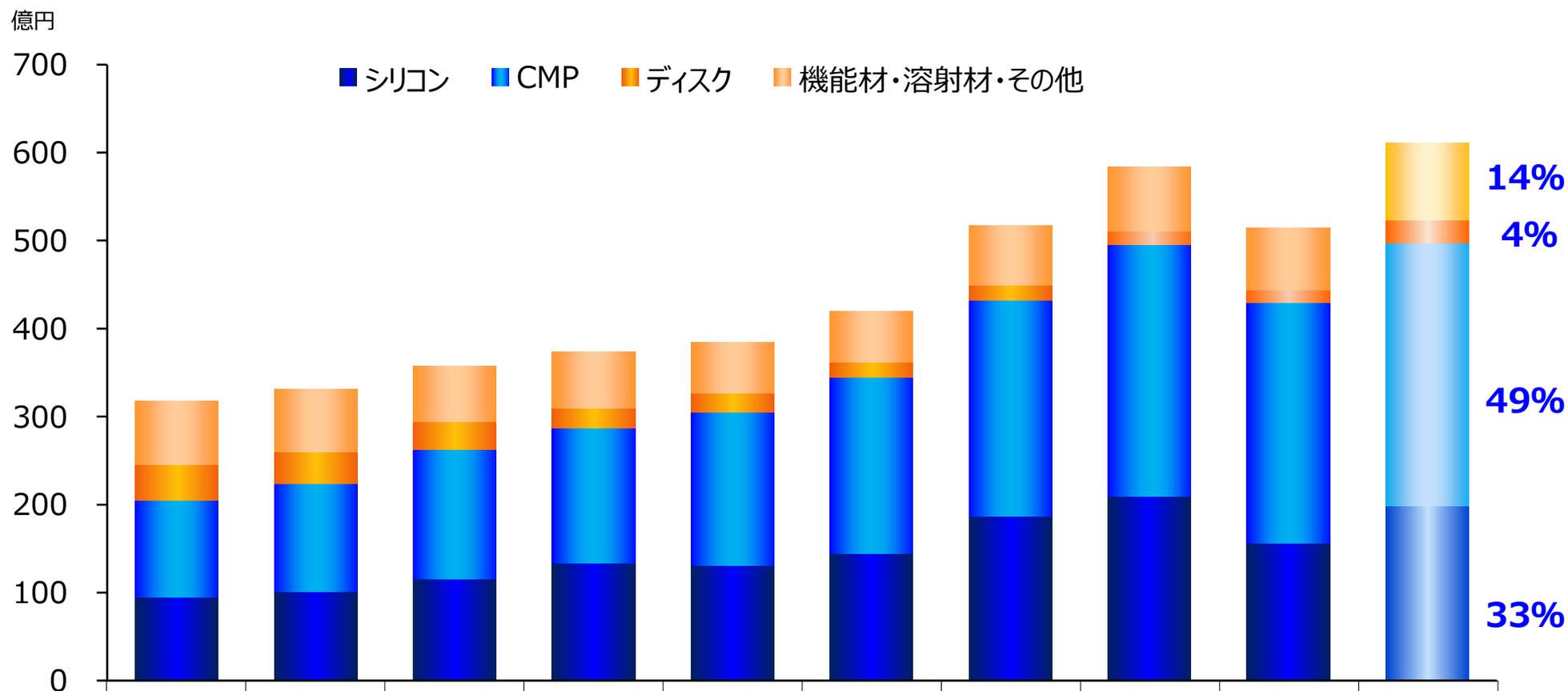
		24年3月期		25年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('24/5)	下期修正予想 ('24/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('24/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,229	2,249	2,639	2,550	2,661	+18.3%	+0.8%	+4.4%
	一般工業用(非研磨材)	1,251	1,228	1,708	1,300	1,692	+37.7%	△1.0%	+30.2%
	計	3,480	3,478	4,348	3,850	4,353	+25.1%	+0.1%	+13.1%

「通期」

単位：百万円

		23年3月期	24年3月期	25年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('24/5)	通期修正予想 ('24/11)	前期比	期初予想比 ('24/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,610	4,479	4,900	5,300	+18.3%	+8.2%
	一般工業用(非研磨材)	2,601	2,480	2,600	3,400	+37.1%	+30.8%
	計	7,211	6,959	7,500	8,700	+25.0%	+16.0%

用途別売上高（通期）



	'16/3	'17/3	'18/3	'19/3	'20/3	'21/3	'22/3	'23/3	'24/3	*'25/3
機能材・溶射材・その他	72	70	63	64	57	57	67	73	70	88
ディスク	40	36	32	22	21	17	17	15	14	26
CMP	109	122	146	153	173	200	246	286	274	299
シリコン	94	100	115	133	131	144	187	209	156	198
計	317	330	357	373	384	419	517	583	514	611

* '25/3は予想値

設備投資額
減価償却費
研究開発費

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

各務山新工場建設（計画）

敷地面積：28千㎡

'21年12月に売買契約を締結

- シリコン、CMP製品の生産能力増強

FUJIMI CORPORATION（米国）

既存工場敷地内に新棟建設を計画

- CMP生産スペース拡大

FUJIMI TAIWAN（台湾）

- 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター（仮称）建設（計画）

敷地面積：16千㎡

現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済

- 非半導体関連の研究施設を設置



中期的な設備投資計画（アップデート）

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ '21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	'24年10月 着工 '25年末 竣工 '26年中 試作品出荷 '27年中 本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品	新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） '25年末 設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、 順次CMP生産設備の導入を計画	'25年末 導入完了 '26年 生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を当下期に開始予定

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

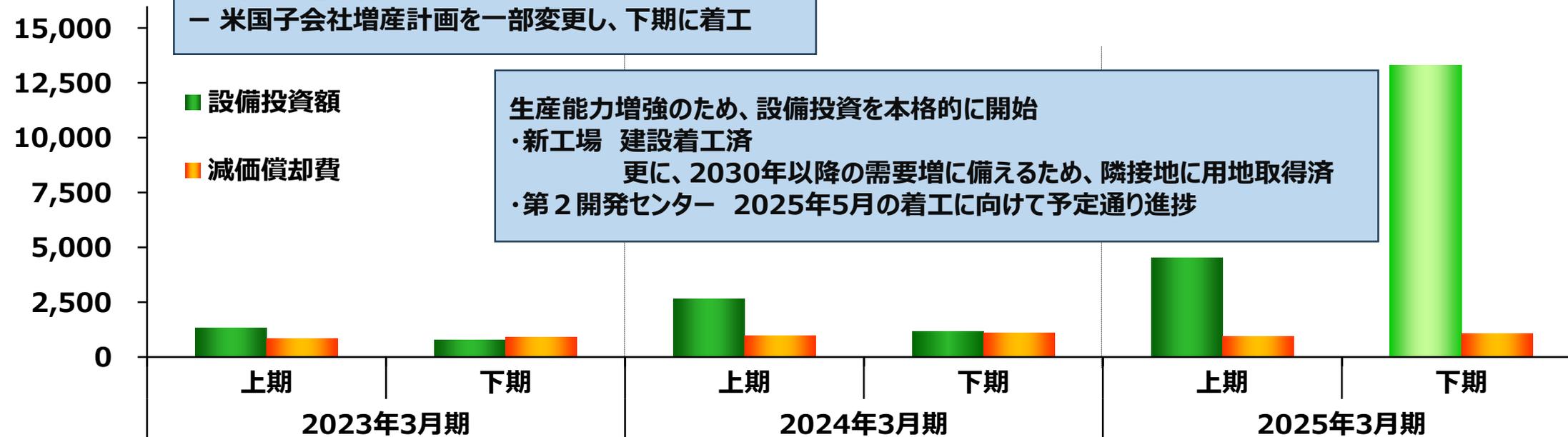
第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置	（現状）'25年5月着工に向けて予定通り進捗（詳細設計中）
--	-------------------------------

設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	24年3月期		25年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('24/5)	上期実績				下期計画 ('24/5)	下期修正計画 ('24/11)			
				前年同期比	前年下期比	計画比 ('24/5)	前年同期比		同年上期比	計画比 ('24/5)		
設備投資額 (支払ベース)	2,656	1,182	3,000	4,473	+68.4%	+278.4%	+49.1%	9,700	10,397	+779.6%	+132.4%	+7.2%
減価償却費	963	1,090	1,050	942	△2.2%	△13.5%	△10.2%	1,050	1,058	△2.9%	+12.3%	+0.1%

百万円



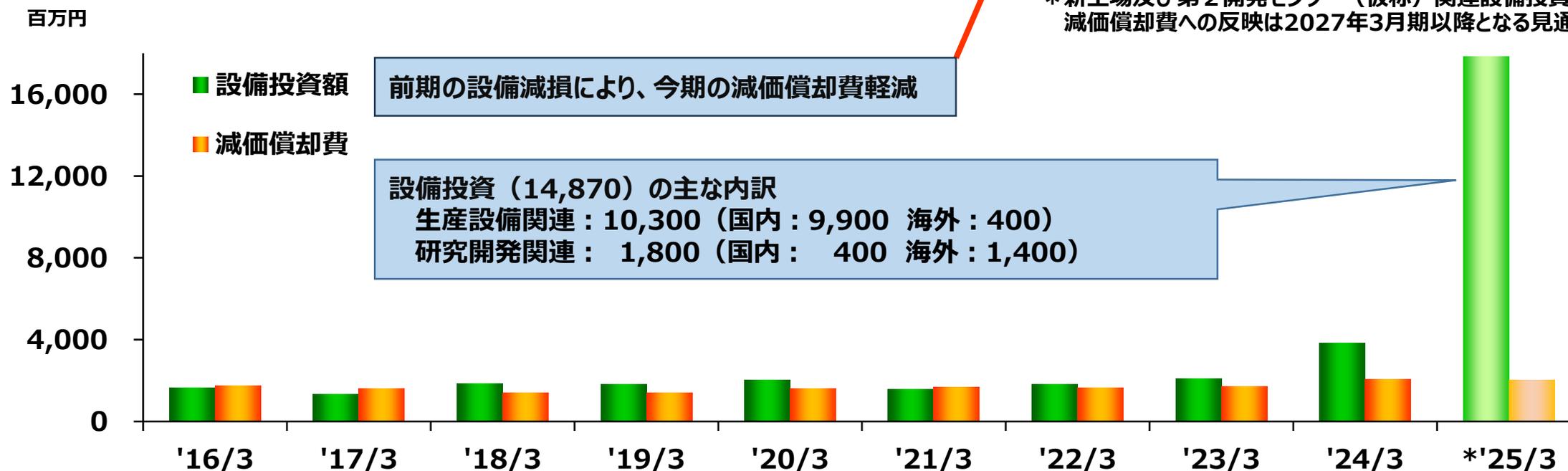
* 新工場及び第2開発センター（仮称）関連設備投資の減価償却費への反映は2027年3月期以降となる見通し

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	24年3月期	25年3月期			
	通期実績	通期計画 ('24/5)	通期修正計画 ('24/11)	前期比	期初計画比 ('24/5)
設備投資額 支払ベース	3,838	12,700	14,870	+287.4%	+17.1%
減価償却費	2,053	2,100	2,000	△2.6%	△4.8%

*新工場及び第2開発センター（仮称）関連設備投資の減価償却費への反映は2027年3月期以降となる見通し

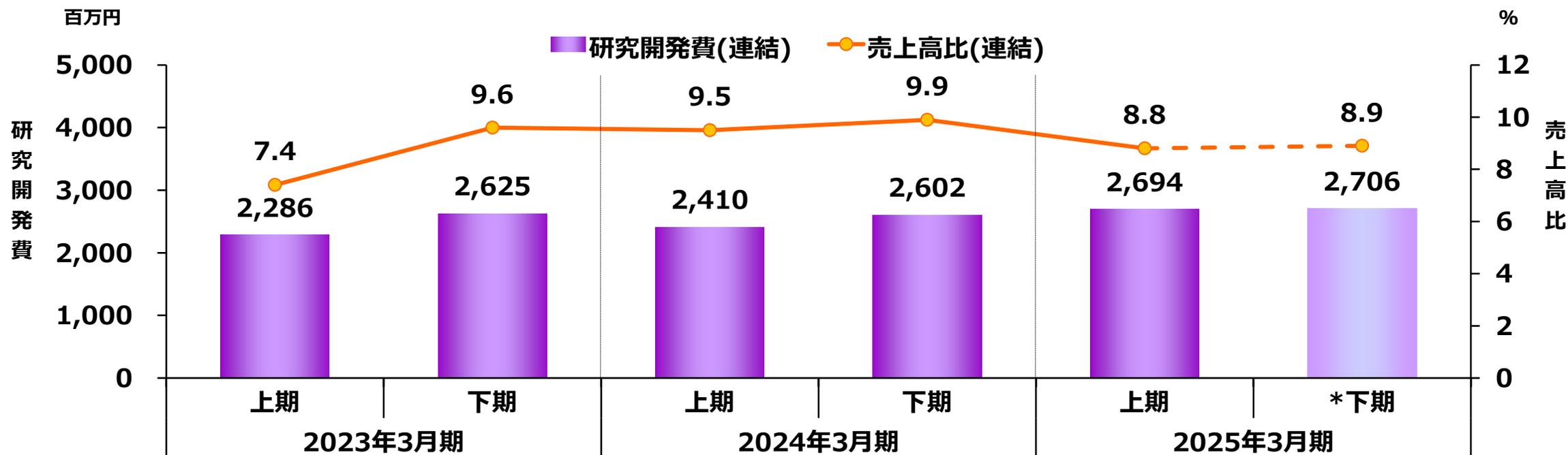


*'25/3は計画

研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

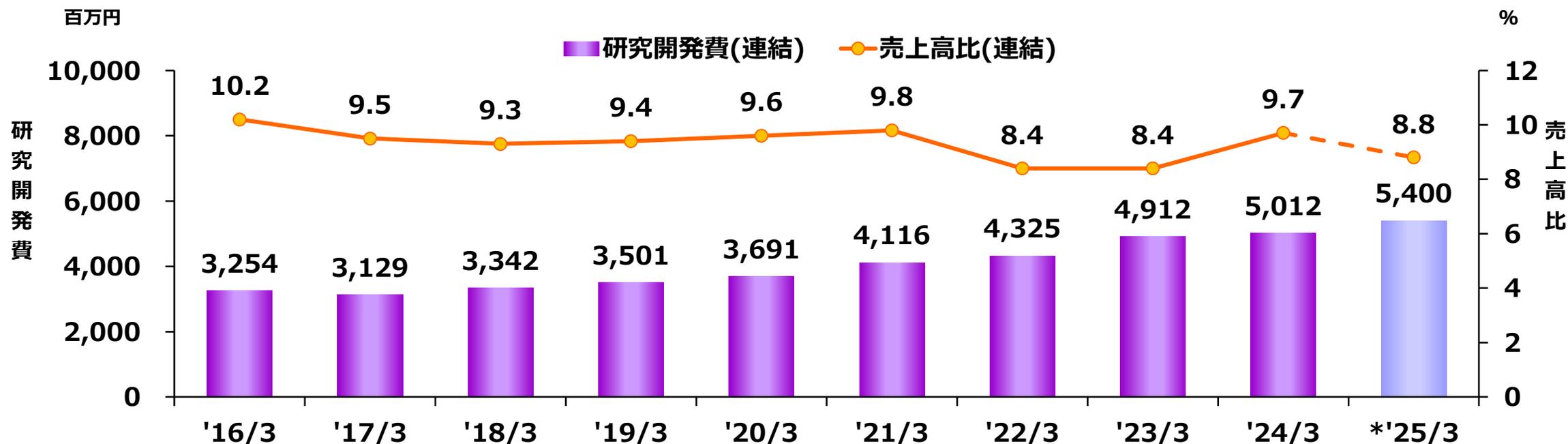
	24年3月期		25年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('24/5)	上期実績	前期			下期計画 ('24/5)	下期修正計画 ('24/11)	前期		計画比 ('24/5)
					前年同期比	前年下期比	計画比 ('24/5)			前年同期比	同年上期比	
研究開発費	2,410	2,602	2,600	2,694	+11.8%	+3.6%	+3.6%	2,600	2,706	+4.0%	+0.4%	+4.1%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	24年3月期	25年3月期			
	通期実績	通期計画 ('24/5)	通期修正計画 ('24/11)	前期比	期初計画比 ('24/5)
研究開発費	5,012	5,200	5,400	+7.7%	+3.8%



* '25/3は計画

損益分析

営業利益増減要因 24/3期上期実績→25/3期上期実績

売上高 253億円

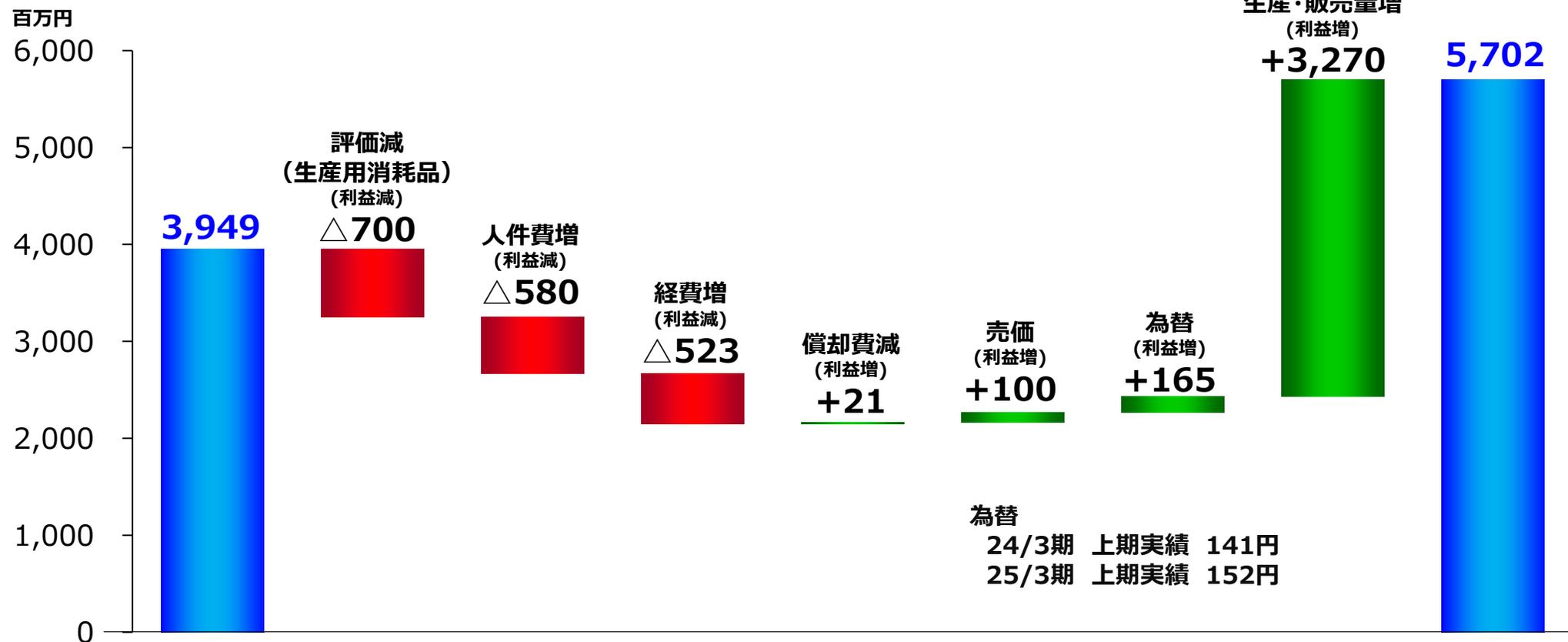
307億円

24/3期
上期実績

(売上増) +5,393

(利益増) +1,753

25/3期
上期実績



営業利益増減要因 24/3期通期実績→25/3期通期予想

売上高 514億円

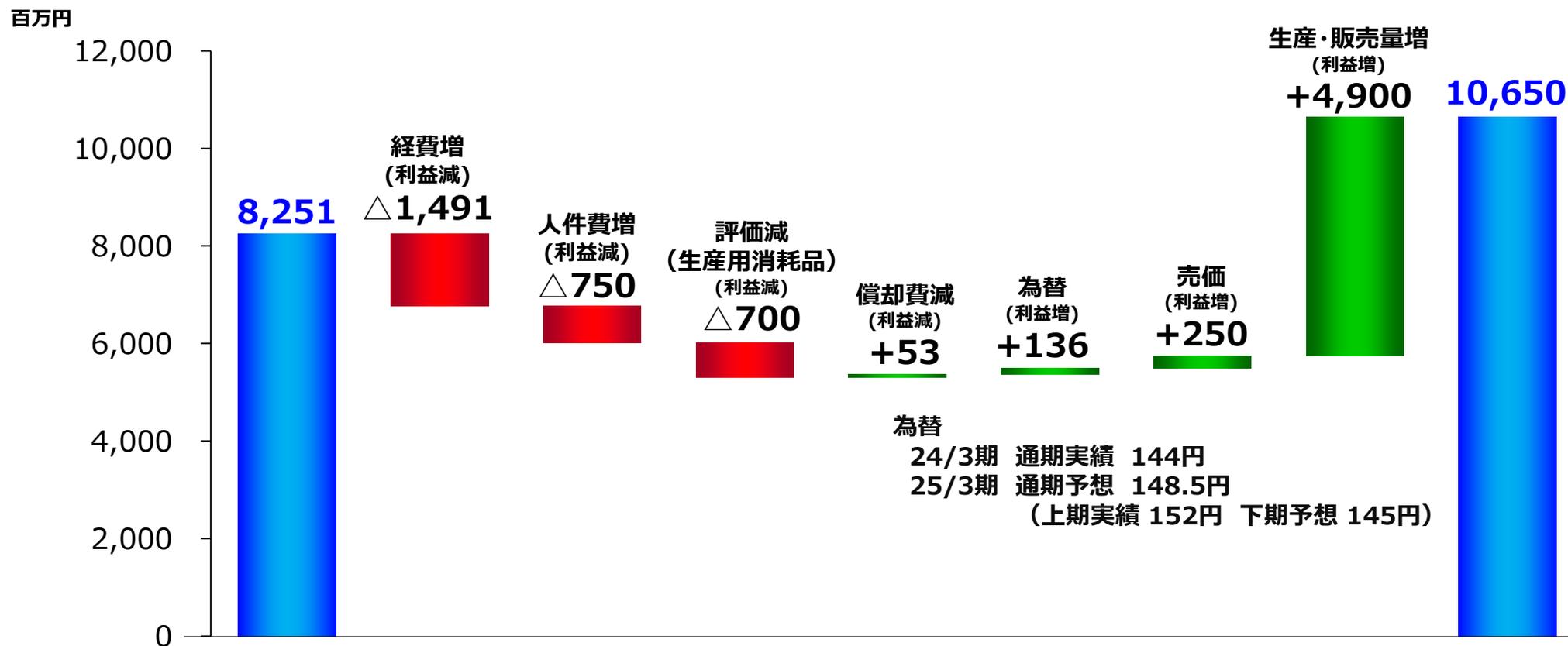
611億円

24/3期
通期実績

(売上増) +9,677

(利益増) +2,398

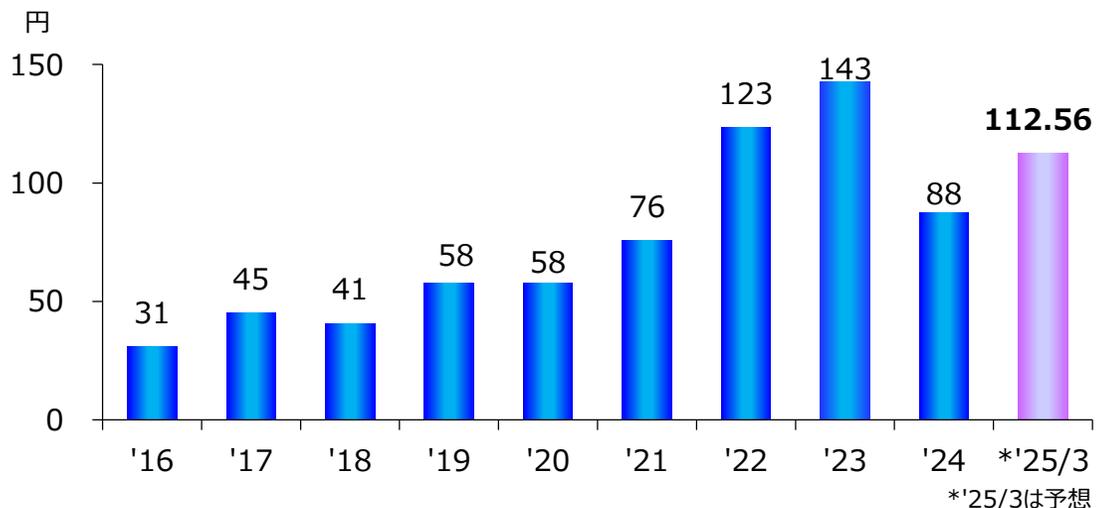
25/3期
通期予想



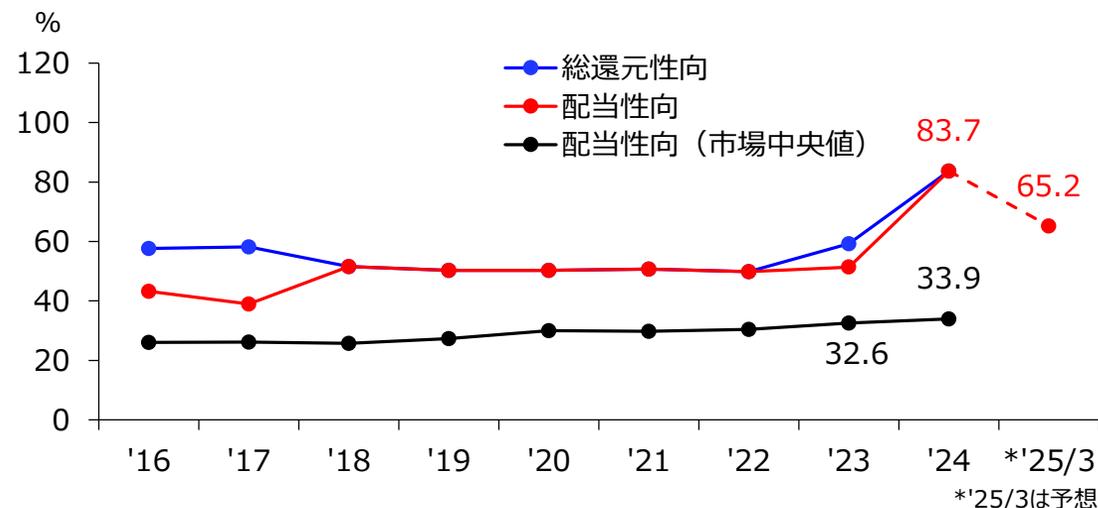
株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

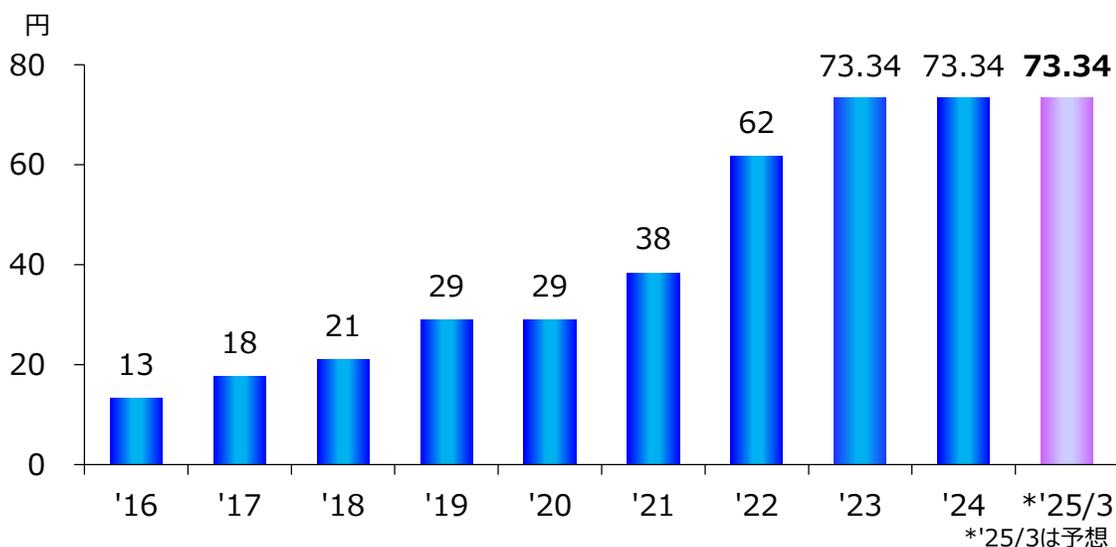
1株当たり当期純利益（分割後）



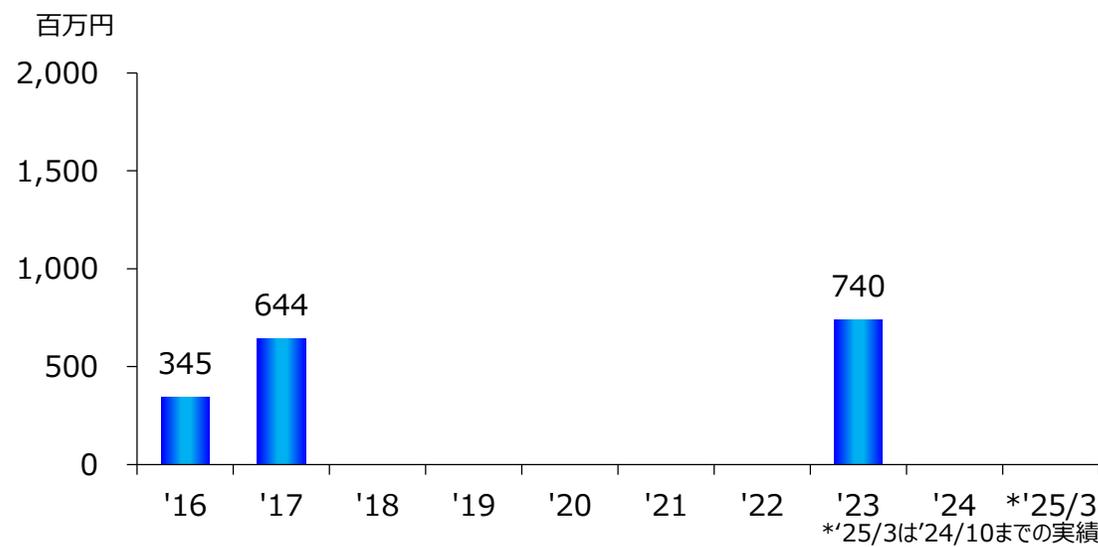
総還元性向・配当性向



1株当たり配当金（分割後）



自己株買い



【2025年3月期 上期業績】 *前年同期比

✓ 売上高	*+21.3%	: 半導体向け製品を中心とした販売増加に加え円安効果
✓ 営業利益	+44.4%	:
✓ 経常利益	+26.9%	: 上期末に向けた一時的な円高の進行による為替差損あり
✓ 四半期純利益	+29.4%	:
✓ シリコンウェハ向け	+18.9%	: 顧客の稼働回復による出荷増とラッピングにおける原材料価格上昇分の製品価格への転嫁もあり増収
✓ CMP向け	+16.0%	: AI関連の先端ロジックデバイスやメモリ向けの販売増加により、増収
✓ ハードディスク向け	+174.2%	: データセンター向けHDDの需要増加を受け、増収
✓ 一般工業用向け	+24.9%	: 各種用途における需要増加と半導体製造装置の堅調な設備投資の影響を受け、増収
✓ 株主還元		: 1株当たり配当額は期初予想通りの36.67円

【2025年3月期 通期業績予想（2024年9月20日付）】 **前年比

✓ 売上高	**+18.8%	} 半導体向け製品を中心に販売の増加を見込む
✓ 営業利益	+29.1%	
✓ 経常利益	+24.5%	
✓ 当期純利益	+28.5%	

新規事業の取組み

区分	取組みの方向性	これまでの実績・現在進めている取組み
SiCパワー半導体向け研磨材	コア技術を基盤とした高研磨能率、低環境負荷性を実現する製品投入によるマーケットシェア拡大	<p>【市場環境】</p> <ul style="list-style-type: none"> SiC半導体市場は、足元で各国のEV補助金の終了、減額などで自動車向け製品の減速がみられるも、SiC半導体各社の中長期的な計画に変更なく、SiC半導体市場の成長の趨勢に変化はないとみられる <p>【当社取組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> 高研磨/高リサイクル性スラリーの展開 米国とマレーシアに生産ラインを設置済み 米国からは同国及び欧州顧客へ、マレーシアからは日本、中国及び東南アジア各国の顧客へ製品を供給 米国拠点では、将来の需要増加に備え、新生産ライン増強の検討を進める

区分	取組みの方向性	これまでの実績・現在進めている取組み
<p>研磨ソリューション</p>	<p>お客様ウォンツに応える先進の研磨ソリューションの提供</p>	<p>【自動車研磨用コンパウンド・金型用研磨材】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自社ブランドを立ち上げ、自動車メーカー、アフターマーケット市場に拡販中。高級車の鏡面磨きやボディコーティング前研磨の短時間化で活用進む ・ 金型磨きにおける人材不足を背景に、磨きの短時間化に貢献する研磨材を開発し、販売開始 <p>【受託加工ビジネス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当社がニーズを探索、研磨プロセスを開発支援し、受託加工先に委託するビジネスモデルを展開中 ・ 半導体装置用部品、次世代デバイス基板、次世代プラスチックレンズなどの難加工材に対するお客様のウォンツに鋭意対応中
<p>先端技術・機能材料</p>	<p>パウダー技術を駆使した機能性材料（セラミックパウダー、セラミック複合材、新規パウダー等）の開発継続・事業化</p>	<p>【機能性材料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ SiC、超硬3D、酸化亜鉛、リン酸チタン等の機能性パウダー及びパウダー技術をベースとしたCMC*向SiC/SiCプリプレグ材を開発、新規顧客との協働を開始 ・ パウダー技術を活かした放熱性、流動性、耐摩耗性、高耐久性等の特徴を有する製品開発し、新規顧客と協働中 ・ 展示会出展、web発信を起点に、デジタルマーケティングの手法も加えて訴求（シーズ発信）し、新規顧客との接触機会増加を図る <p style="text-align: right;">*CMC: Ceramic Matrix Composite（セラミックス基複合材料）</p>

APPENDIX

各 位

2024年10月21日

株式会社 フジミインコーポレーテッド

南興セラミックス株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社フジミインコーポレーテッド（本社：愛知県清須市、代表取締役社長：関 敬史、以下「フジミ」）は、2024年10月21日付で、南興エステート株式会社（2024年10月18日付で商号を南興セラミックス株式会社から変更）より、南興エステート株式会社が新設分割により設立し、研磨材等の製造・販売事業を承継させた新設会社である南興セラミックス株式会社（以下「南興セラミックス」）の発行済株式の75%を取得し、同社を連結子会社化しましたので、お知らせ致します。

名称	南興セラミックス株式会社 (NANKO ABRASIVES INDUSTRY CO.,LTD.)
設立年月日	2024年10月18日 (創業1946年)
本社所在地	〒114-0004 東京都北区堀船2-19-19 パレ・ドール王子ビル 5階 (TEL : 03-6903-3117 FAX : 03-5902-3095)
資本金	10百万円
事業内容	研磨材、耐火材の製造および販売
役員	代表取締役会長 松本 昌彰 代表取締役社長 杉山 嘉一 取締役 (非常勤) 日比 勝之 株式会社フジミインコーポレーテッド 人事・組織開発本部長 監査役 (非常勤) 関 敬史 株式会社フジミインコーポレーテッド 代表取締役社長
生産拠点	塩尻工場 : 〒 399-6461 長野県塩尻市大字宗賀字牧野3661 (TEL : 0263-52-4152 FAX : 0263-52-5501) 市川工場 : 〒 409-3603 山梨県西八代郡市川三郷町黒沢598-5 (TEL : 055-272-0911 FAX : 055-272-3790)
従業員数	44名 (2024年10月18日時点)
売上高 (研磨材事業)	1,453百万円 (2023/11期)
株主 (株式比率)	株式会社フジミインコーポレーテッド (75.0%) 南興エステート株式会社 (25.0%)

昭和21年	(1946年)	千代田区飯田町に合資会社「南興商会」として発足
昭和24年	(1949年)	板橋区中丸町に工場を得て、本格的に研磨材製造業界に進出
昭和33年	(1958年)	株式会社に組織変更
昭和36年	(1961年)	埼玉県富士見市に埼玉工場を建設
昭和38年	(1963年)	茨城県に主として石材用研磨材販売を目的とした真壁出張所（のちに営業所に変更）を開設
昭和41年	(1966年)	研磨微粉の品質の安定化が認められ、日本工業規格許可工場となる
昭和49年	(1974年)	合併会社南興研磨材工業股份有限公司（資本金日本円換算6,000万円）を台湾に設立
昭和51年	(1976年)	長野県塩尻市に塩尻工場を建設
昭和63年	(1988年)	山梨県西八代郡市川三郷町に市川工場を建設。精密な研磨微粉のニーズに対応する体制が整う
平成2年	(1990年)	塩尻工場内に流通センターを設置
平成10年	(1998年)	中国蘇州に生産子会社を設立
平成14年	(2002年)	中国天津に生産子会社を設立
平成16年	(2004年)	埼玉工場を閉鎖
平成18年	(2006年)	中国蘇州の生産子会社を閉鎖
平成29年	(2017年)	本社を現在の東京都北区に移転
令和6年	(2024年)	営業体制の集約化に伴い、真壁営業所を閉鎖
		研磨材等の製造・販売事業を承継させた新設子会社を設立し、新設子会社が商号「南興セラミックス株式会社」を承継 株式会社フジミインコーポレーテッドが南興セラミックス株式会社の発行済株式の75%を取得し、同社の連結子会社となる



「磨く、研ぐ、削る」に特化した高い技術力

当社は研磨材を主な事業の柱とし、創業から「魅力ある研磨材」について考え続けています。インゴットに大きく影響を受ける原料砥粒の加工技術や南興特有の緻密な分級技術まで、そのノウハウすべてを未来へと実直に継承し続けています。



原料メーカーとの強いコネクション

現在、研磨材の原料となるインゴットとそれを加工してできる研磨材を日本国内で製造しているメーカーはほぼ存在していません。国内メーカーが販売している多くの研磨材は、国外の原料メーカー等を介して原料を輸入し国内にて再加工をおこなった後に販売されています。そのため、原料メーカーの良し悪しによる影響は非常に大きく、状況に応じた見極めと日々のコンタクトが最重要だと認識しています。当社ではトップ層自らが原料メーカーとコミュニケーションを取り、細やかな相談を行うことで、現在まで非常に良好な関係を築くことができています。



お客様の信頼に応える柔軟な対応力

当社では研磨材を使い製品加工をすることはありません。ですから、お付き合いをさせていただいているお客様一社一社から当社研磨材に関するフィードバックを頂戴して、工場の生産に反映できるよう努めています。我々の事業継続において、お客様からの叱咤激励は欠かせないエネルギーです。



1946年から続く実績と安心感

世界を取り巻く多様な情勢に耐え抜き、一度も生産を停止することなく、継続して発展することができた実績と自負があります。世界的に原料の入手や生産が困難な状況下においても、常に高い品質を維持しつつ安定した供給を実現できる強固な体制をお約束いたします。

炭化ケイ素（GC/C）、アルミナ（WA/A）などの研磨材について粗粒から微粉までの全番手を製造しています。
その他粒度に関してはご相談ください。



GC
緑色炭化ケイ素



C
黒色炭化ケイ素



WA
白色電融アルミナ



A
かっ色電融アルミナ

粒度 粗粒（～F220）
微粉（#240～#8000）

用途 半導体、太陽電池等のシリコン
基板
コーツ・クリスタル、サファイ
ヤ・クリスタル等の光学製品
ハードディスク等の電子部品

粒度 粗粒（～F220、～P220）
微粉（#240～#4000）

用途 精密砥石材料（アルミディスク、
各種磁性材料の精密研磨用）
研磨布紙材料（自動車、木工、金属
製品の精密研磨用）など

粒度 粗粒（～F220、～P220）
微粉（#240～#8000）

用途 精密砥石材料（ミニチュアベアリ
ング、メカニカルシール等の精密
研磨用）
ラッピングテープ材料（各種電子
部品研磨用）など

粒度 粗粒（～F220、～P220）
微粉（#240～#6000）

用途 光学製品、精密部品等の研磨
各種精密砥石材料
各種研磨布紙材料

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED